



2023年3月期

(2022年4月1日 ~ 2023年3月31日)

# 決算説明資料

**ENOMOTO Co.,Ltd.**

東証プライム 証券コード:6928

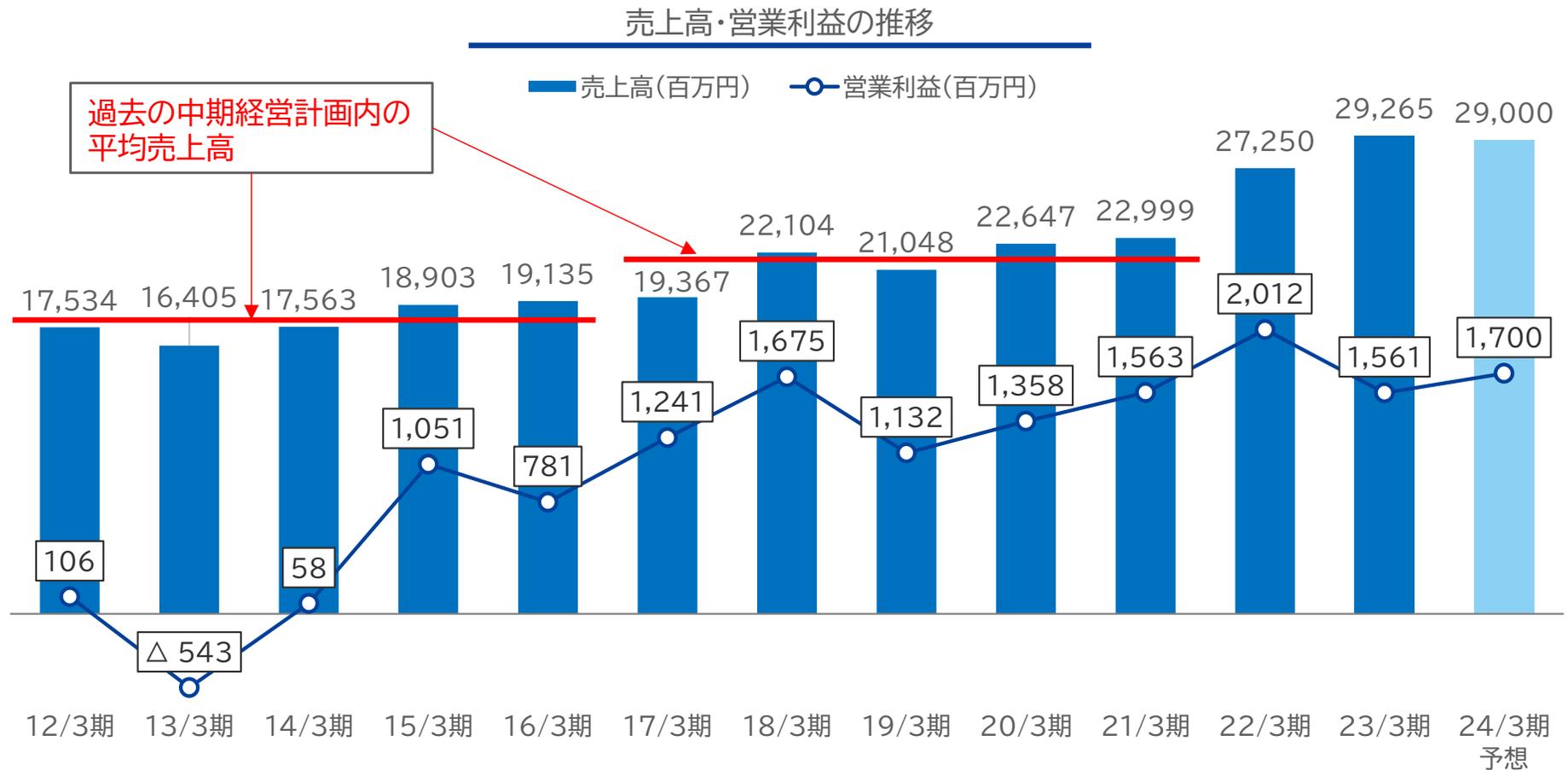
(1) 業績概要	P. 3
(2) 市場環境と当社製品	P. 6
(3) 2023年3月期決算	P.17
(4) 2024年3月期業績予想	P.23
(5) 中期経営計画の進捗	P.26
(6) 中期環境計画の進捗(SDGsへの取組み)	P.37

## Appendix

# (1)業績概要



- 2021年3月期までの5年間は、スマートフォン向けのマイクロコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- 22年3月期はマイクロコネクタ・パワー半導体用リードフレームがともに好調に推移し売上高272億円、営業利益20億円と過去最高益を計上
- 23年3月期の売上はパワー半導体用リードフレームの好調で過去最高だったが4Qからのスマートフォン向け生産調整で減益。24年3月期下期からの回復を目指す



- ・ リードフレームでは車載や産機向けなどにパワー半導体向け製品が伸長
- ・ コネクタ用部品ではマイクロコネクタが伸長、ただし4Qにスマートフォン向けの生産調整により前期並み
- ・ リードフレーム、コネクタ用部品概ね半分とバランスが取れた事業構成

## その他

売上高 659百万円  
 前同比  $\Delta 2.8\%$   
 構成比 2.3%

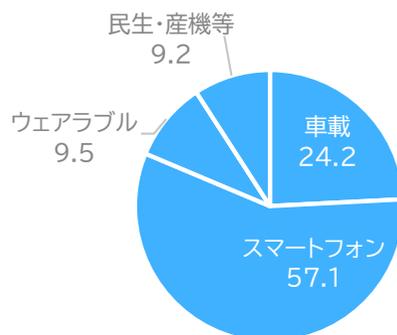
## パワー半導体用リードフレーム

売上高 11,973百万円  
 前同比 20.6%  
 構成比 40.9%



## コネクタ用部品

売上高 12,912百万円  
 前同比  $\Delta 0.3\%$   
 構成比 44.1%



売上高  
**29,265**百万円  
 (2023/3期)

## オプト用リードフレーム

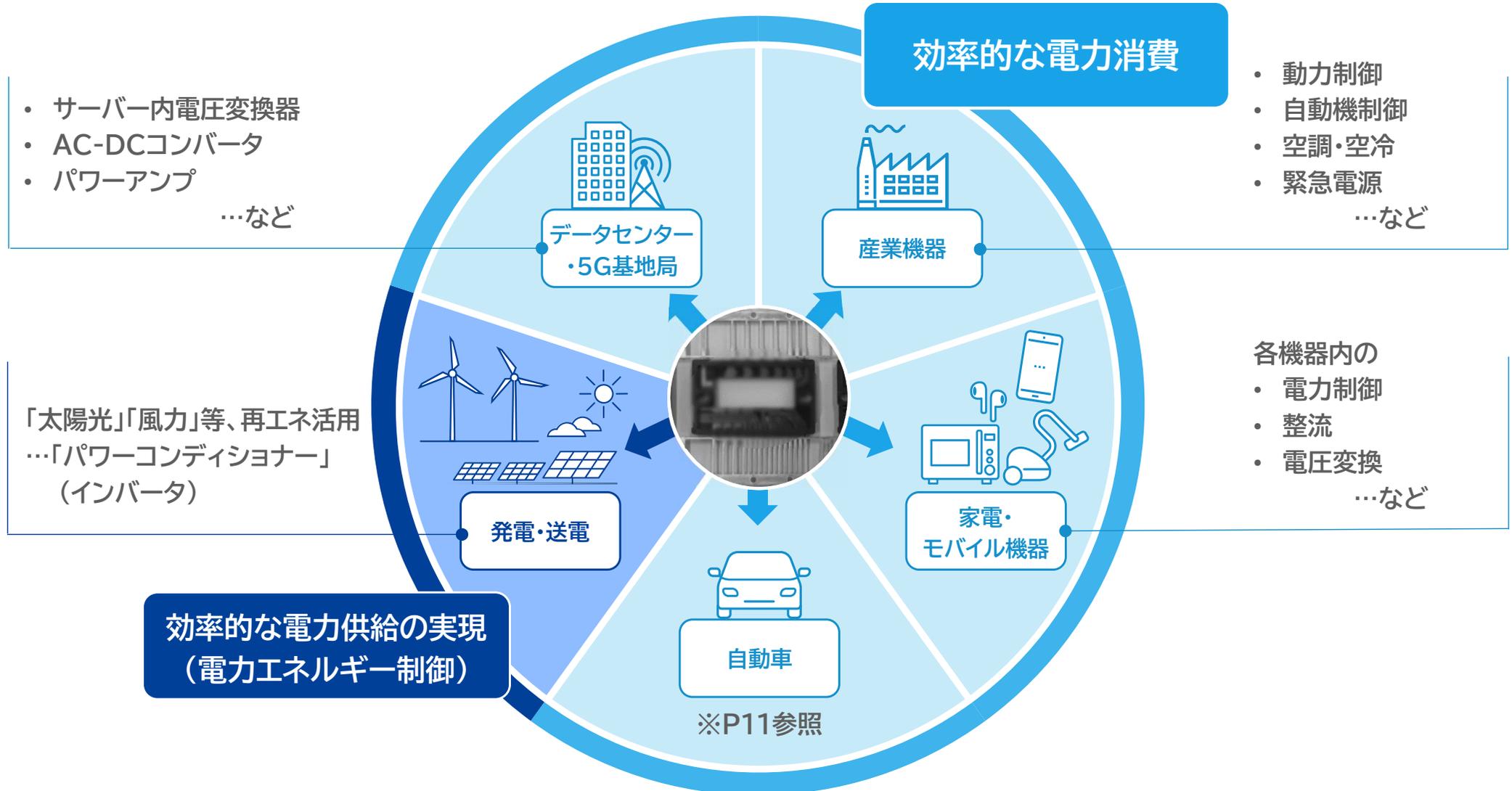
売上高 3,719百万円  
 前同比 0.9%  
 構成比 12.7%



## (2)市場環境と当社製品



- 環境側面からも、新たな発電技術の開発・発展、高効率な電力供給を支える高機能パワー半導体に注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・高電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与

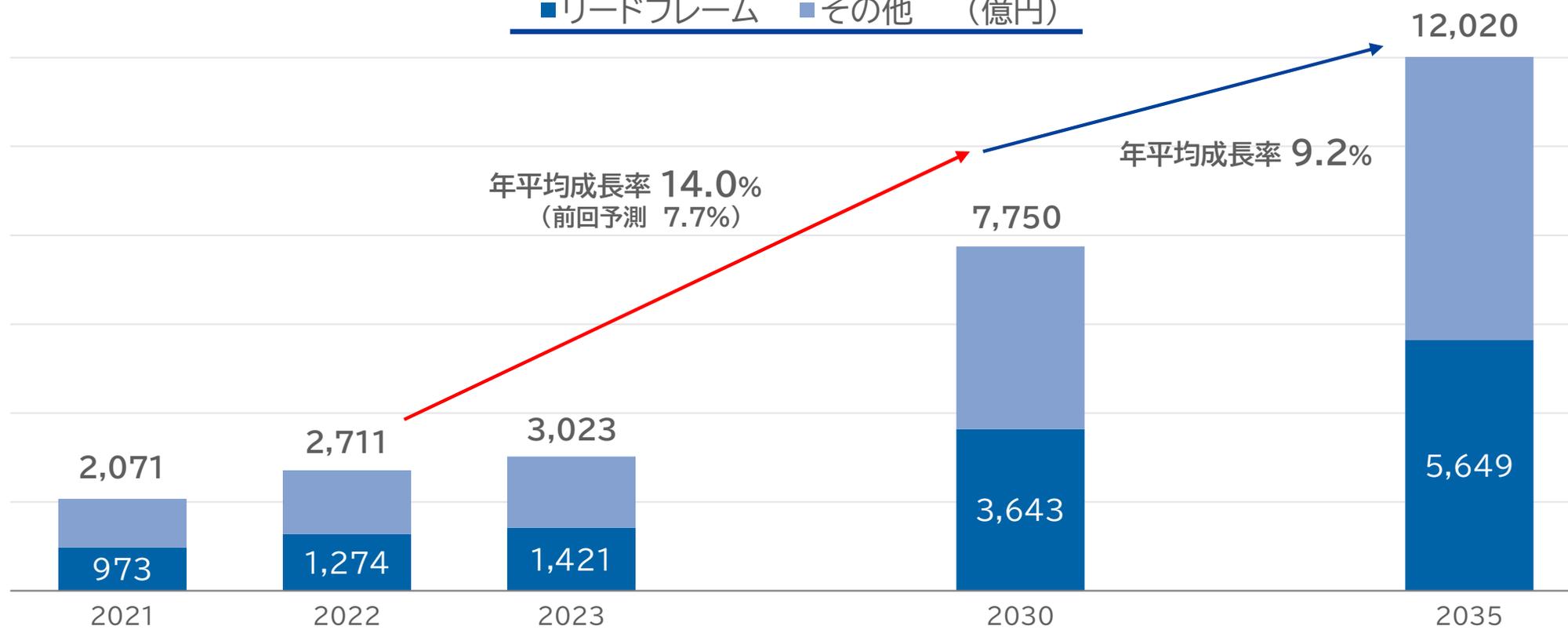


\* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

- リードフレームを含むパワーデバイス構成部材\*は2035年には1兆2,020億円へ2030年までの年平均成長率は14%と、前回予想の7.7%から大幅に上方修正された
- 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

## パワーデバイス構成部材の市場予測

■ リードフレーム ■ その他 (億円)



予測

\* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳  
出所:富士経済「2023年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」

- 車載ECU\*1やデータセンター向けパワー半導体の高電圧・高電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディングの注目が高まる
- 需要は拡大しており2023年3月期に前倒しで生産能力を増強。平坦度などの品質要求が高く付加価値率も高い

車載・産業用パワー半導体

小型化

高電流化

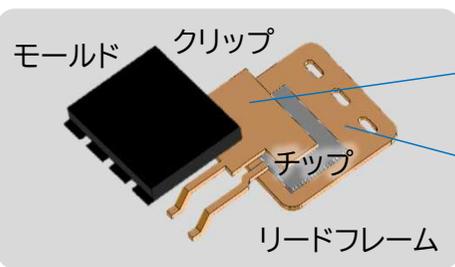
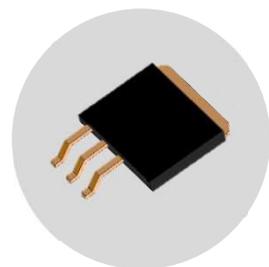
モジュール化



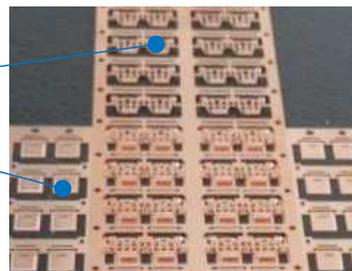
従来品を上回る高信頼性と省スペース性

## クリップボンディングリードフレーム

完成品



当社製品



高耐熱性

長寿命化

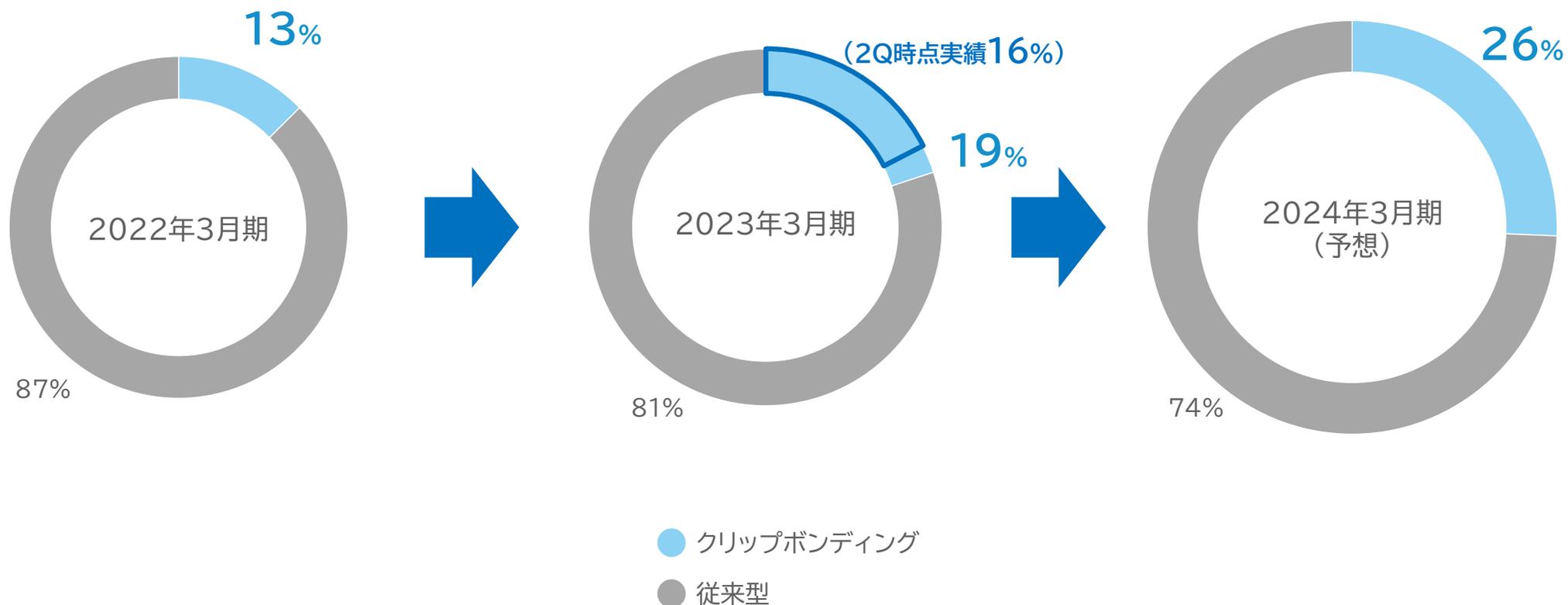
- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度(位置精度)が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

平坦度(位置精度)・清浄度の要求が高く、高い付加価値率  
他社に先駆けて本格量産開始

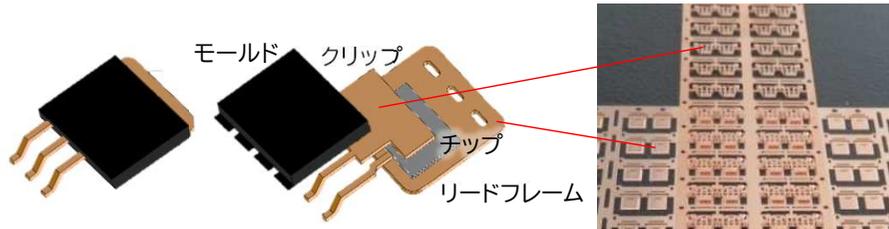
\*1 ECU Electronic Control Unit

- 当社のパワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの売上構成比率は2022年3月期の13%から2023年3月期は19%まで成長
- 先行している中国に加えて、日本・フィリピンでの生産拡大を見込む2024年3月期は26%まで上昇の見通し
- 当社はクリップボンディングリードフレームの量産で先行、従来型リードフレームに比べて付加価値も高いクリップボンディングの市場拡大により、リードフレーム事業の売上拡大と利益率向上を目指す

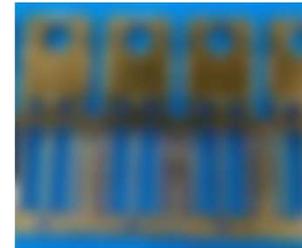
パワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの構成比



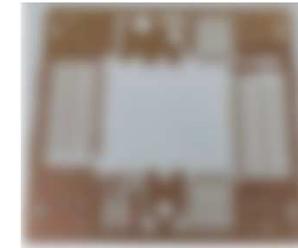
## クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



汎用パワー半導体用  
リードフレーム



IGBT用  
リードフレーム



パワーIC用  
リードフレーム



- 上記部品が後工程を経てパワーデバイスモジュールを構成し、車載(制御系など)に使用される
- EV等の新エネルギー車向けで、クリップボンディング方式が適するSiCパワーデバイスの需要拡大
- 主に中国のEV向けに需要拡大

## パワーデバイス適用製品

計40品種以上

### パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- レギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



### 車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

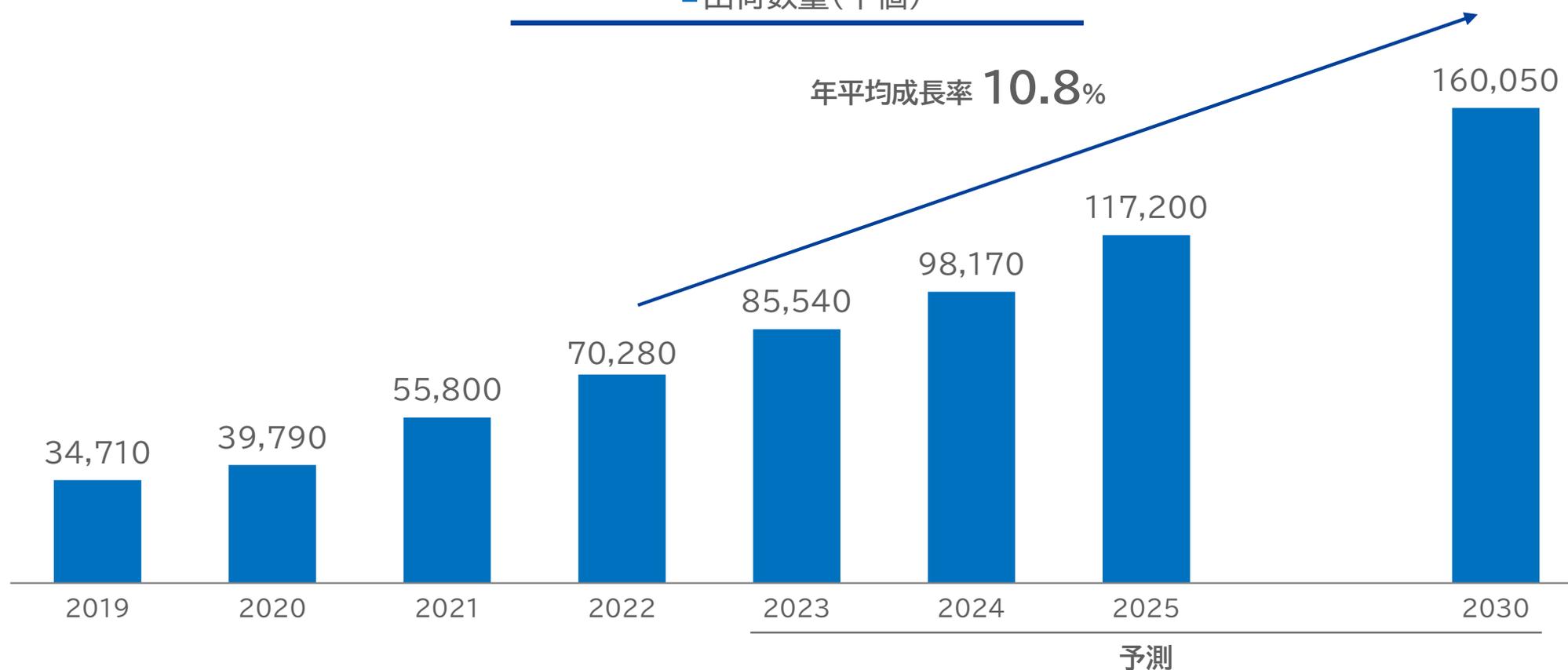
### ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

- 車載向けパワーデバイスモジュールは、日本ではHV向け、欧州、北米、中国はPHV\*やEV向けの製品が拡大  
2030年までに出荷数量は年平均10.8%成長を予測

## 車載向けパワーデバイスモジュールの出荷数量

■ 出荷数量(千個)

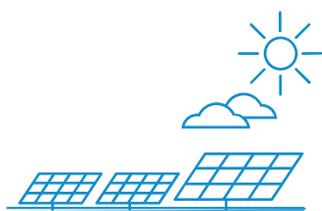


\* PHVはPlug in Hybrid Vehicle の略  
出所:富士キメラ総研「2021 次世代カーテクノロジーの本命予測」

- 温室効果ガス排出実質ゼロの実現にはあらゆる分野・製品のエネルギー効率向上が必要
- 世界の電力の50~60%はモータで消費すると言われ、インバータによる効率的な電力の変換や制御のため高機能パワー半導体がキーデバイスとなる

## 「温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現へ 「GX」とは ... 「パワービジネス」

あらゆる分野・製品のエネルギー効率向上



発電



自動車(EV)



空調



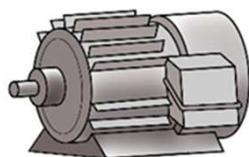
ロボット



家電/デジタル家電

### 省エネの実現

インバータ、コンバータ、レギュレータetc...



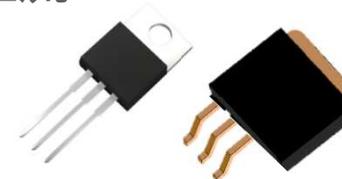
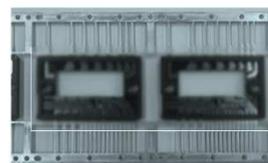
モータ

### パワー半導体

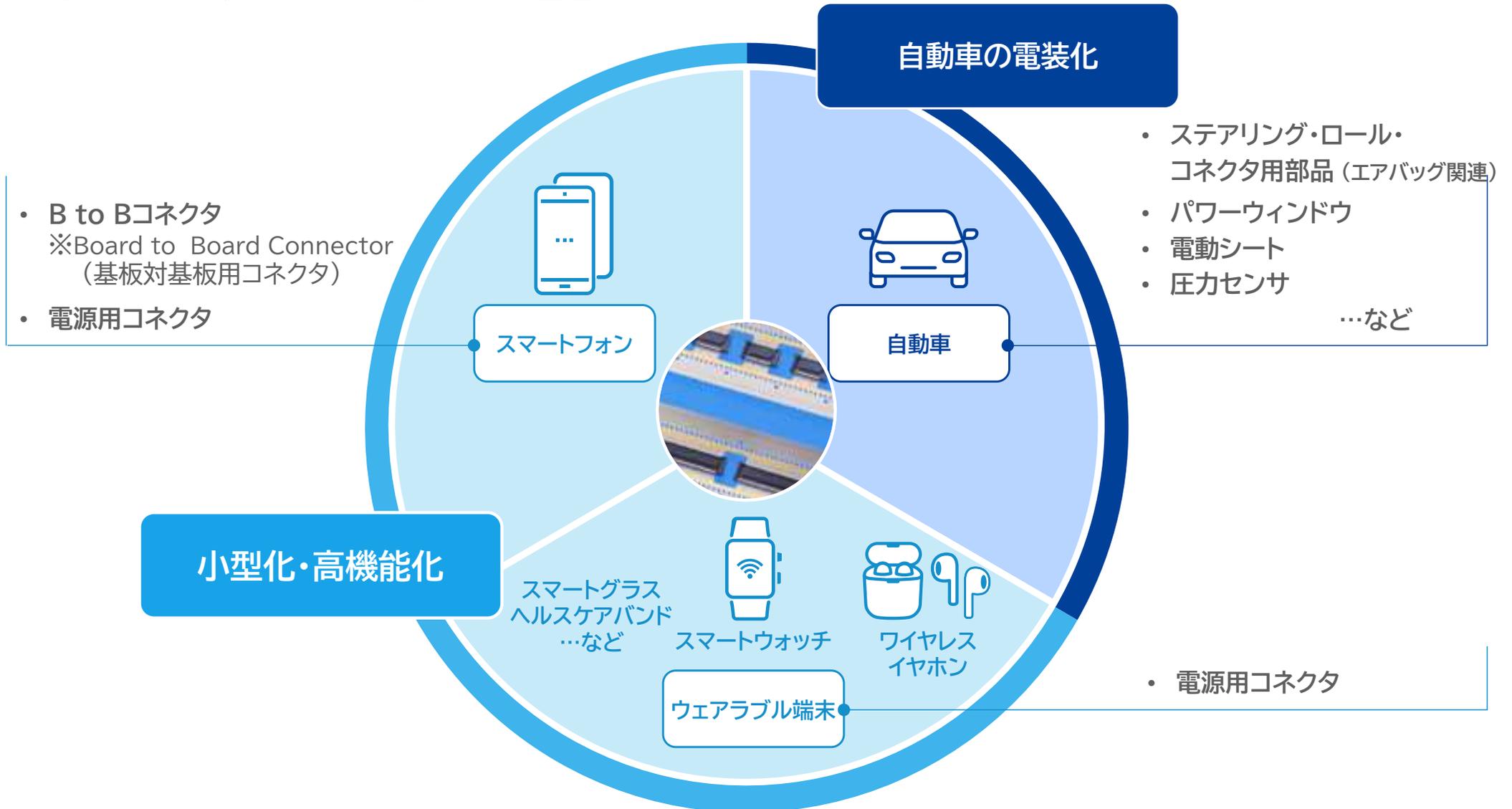
整流

電圧変換

交流⇔直流

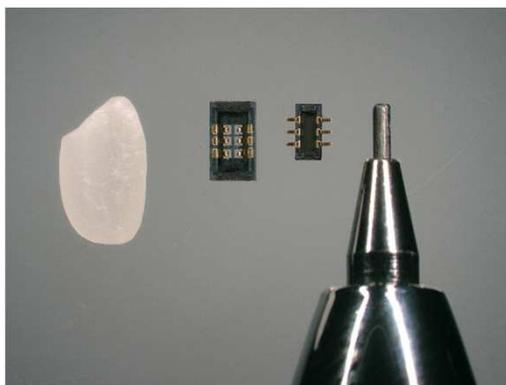


- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細で高品質な部品を安定して大量生産



1

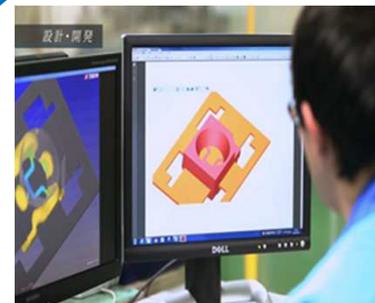
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える  
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制

中国

クリップボンディング  
リードフレームで先行



フィリピン

車載向けコネクタ用部品の  
主力工場



一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや  
協力会社

幅広い顧客  
ニーズ

最適な調達



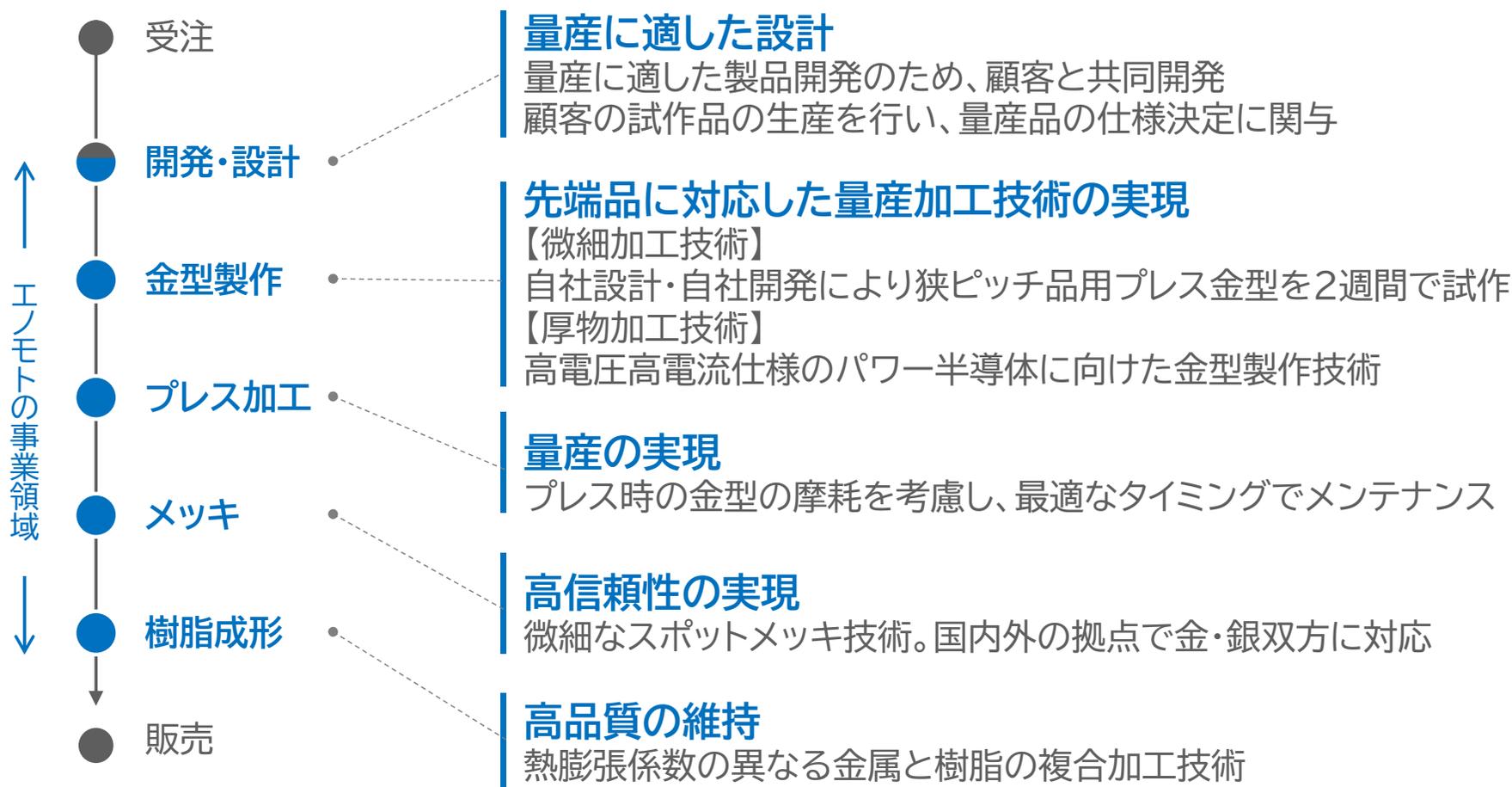
エノモト



柔軟な対応

特定の資本に縛られない  
自由な営業方針

- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどのマイクロコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



# (3)2023年3月期決算



- ・ 増収要因はパワー半導体用リードフレームの好調と、円安の影響(7.8%)により過去最高
- ・ 一方で、営業利益は4Qのコネクタ用部品の生産調整の他、生産能力増強に伴う減価償却費や人件費の増加及びエネルギーコスト上昇による電力費等、販売価格転嫁が追いつかず減益

(百万円)	2022/3期		2023/3期		2023/3期		期比較	
	実績	売上比(%)	従来予想	売上比(%)	実績	売上比(%)	前年比(%)	従来予想比
売上高	27,250	100.0	29,400	100.0	<b>29,265</b>	<b>100.0</b>	+7.4	△0.5
売上総利益	4,462	16.4	4,400	15.0	<b>4,100</b>	<b>14.0</b>	△8.1	△6.8
販管費	2,449	9.0	2,600	8.8	<b>2,538</b>	<b>8.7</b>	+3.6	△2.4
営業利益	2,012	7.4	1,800	6.1	<b>1,561</b>	<b>5.3</b>	△22.4	△13.3
為替差損益	34	-	-	-	<b>37</b>	-	-	-
助成金収入	8	-	-	-	<b>157</b>	-	-	-
経常利益	2,054	7.5	2,000	6.8	<b>1,805</b>	<b>6.2</b>	△12.1	△9.7
当期純利益	1,545	5.7	1,600	5.4	<b>1,269</b>	<b>4.3</b>	△17.9	△20.7
1株当たり純利益	230.5円	-	239.6円	-	<b>190.0円</b>	-		

- ・ パワー半導体向けリードフレームは好調に推移し、円安影響もあったがコネクタ用部品の生産調整で売上高は前年同期並み
- ・ コネクタ用部品の生産調整の影響と固定費増加の影響が大きく営業利益は大幅減益

単位:百万円	2022/3期					2023/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	6,866	6,848	6,992	6,543	27,250	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265
売上総利益	1,196	1,086	1,143	1,035	4,462	1,155	1,017	1,231	695	4,100
販管費	553	579	659	657	2,449	619	615	655	648	2,538
営業利益	643	507	483	377	2,012	536	401	575	46	1,561
為替差損益	△11	7	20	19	34	84	53	△80	△20	37
経常利益	639	526	538	349	2,054	638	489	516	161	1,805
四半期純利益	482	365	372	324	1,545	431	346	433	57	1,269

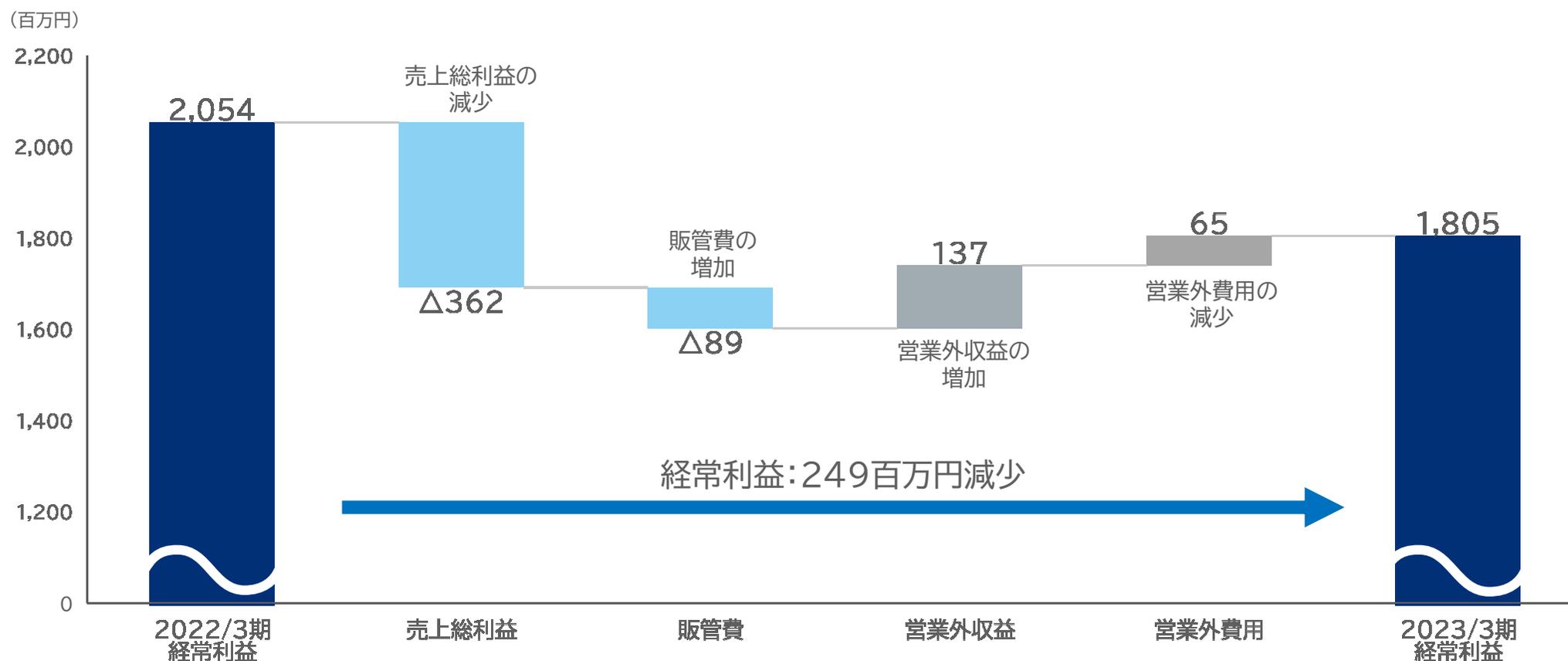
# 製品群別四半期売上高(第4四半期)

- ・ パワー半導体用リードフレームは、自動車向けを中心に堅調に推移
- ・ オプト用リードフレームは、中国向け需要の下げ止まりと4Qの北米サイネージ向けの増加
- ・ コネクタ用部品は、スマートフォンの需要減少による生産調整

単位:百万円	2022/3期					2023/3期					期比較	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	4Q 前同比	前期比
パワー半導体用 リードフレーム	2,380	2,309	2,592	2,646	9,929	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	+17.7%	+20.6%
オプト用 リードフレーム	969	921	878	916	3,686	1,008	931	854	925	3,719	+0.9%	+0.9%
コネクタ用部品	3,320	3,440	3,353	2,840	12,955	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	△16.2%	△0.3%
その他	195	176	166	141	679	143	180	180	155	659	+11.0%	△2.8%
合計	6,866	6,848	6,992	6,543	27,250	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	+0.5%	+7.4%

※2023年3月期より製品分類を一部変更し、「パワー半導体用リードフレーム」と「その他」の間で数値の組み換えを行いました。前年度は組み換え後の数値を記載しております。

- 売上総利益の減少 … ① 4Qのスマートフォン向けコネクタ用部品の生産調整  
② 製品ミックスの変動と、生産能力増強に伴う減価償却費、人件費等の増加  
③ エネルギーコスト上昇による電力費の増加
- 販売管理費の増加 … ① 円安による円換算額の増加と、物流価格の高騰等による経費の増加  
② 人件費、開発費用の増加
- 営業外収益の改善 … 津軽工場増設に伴う助成金収入の増加等



- 車載向けはパワー半導体用リードフレームが好調
- スマートフォン向けは4Qで生産調整、ウェアラブル向けは前半好調であったが4Qで調整
- 民生・産機・その他向けはデータセンター向け等のパワー半導体用は好調、LED用が減速

## 民生・産機・その他

- 構成比は前期の38.0%から 2.9pt減少  
前期比6.5%減少
- データセンター向け、産機向けのパワー半導体用  
リードフレームは堅調
- 交通インフラ等のディスプレイ向けLED用  
リードフレームが減速

## ウェアラブル

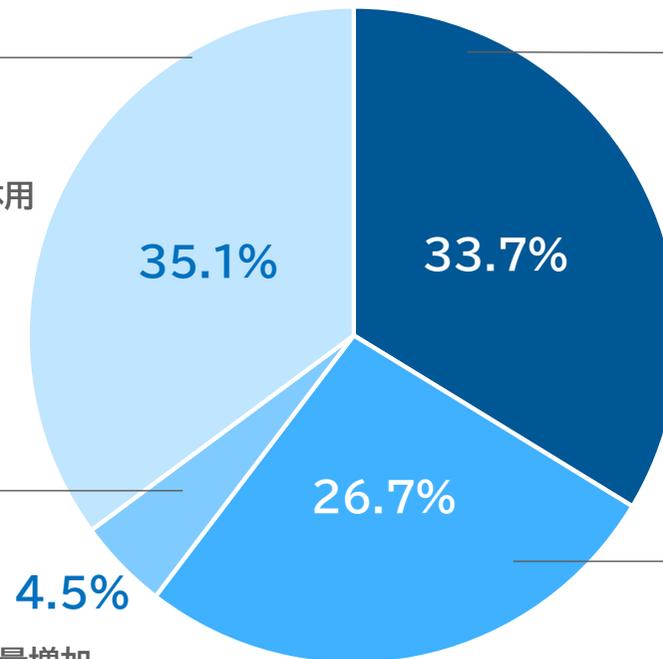
- 構成比は前期の3.5%から 1.0pt増加  
前期比24.7%増加
- 増減の波が大きく、  
3Qまではワイヤレスイヤホン向けを中心に数量増加

## 車載

- 構成比は前期の30.2%から 3.5pt増加  
前期比10.0%増加
- xEV向けパワー半導体用リードフレームが好調
- 自動車の生産調整影響でエアバッグ用コネクタ等  
が減少

## スマートフォン

- 構成比は前期の28.3%から 1.6pt減少  
前期比7.0%減少
- スマートフォンの生産調整の影響



## (4)2024年3月期業績予想



- ・ パワー半導体向け等のリードフレームは堅調だが、年度前半のコネクタ用部品の生産調整により、売上高は前期並み
- ・ クリップボンディングリードフレームの増加やマイクロコネクタの下期以降の回復により、営業増益を予想
- ・ 前期に計上した津軽工場増設に伴う助成金収入等がなくなることから、経常減益予想

	2023/3期実績		2024/3期予想		期比較	
	実績(百万円)	売上比(%)	予想(百万円)	売上比(%)	前年比(%)	売上比増減(pt)
売上高	29,265	100.0	29,000	100.0	△0.9	-
売上総利益	4,100	14.0	4,300	14.8	+4.9	+0.8
販管費	2,538	8.7	2,600	9.0	+2.4	+0.3
営業利益	1,561	5.3	1,700	5.9	+8.9	+0.5
経常利益	1,805	6.2	1,700	5.9	△5.9	△0.3
当期純利益	1,269	4.3	1,250	4.3	△1.5	△0.0
1株当たり純利益	190.0円	-	187.1円	-	-	-

- ・ パワー半導体用リードフレームは自動車や産業機器向けなどの伸長により増収を予想
- ・ オプト用リードフレームは、中国市場の底打ちから微増を予想
- ・ コネクタ用部品はウェアラブル端末向けや自動車向けの下期以降の回復を予想するがスマートフォン販売や、自動車生産の回復動向がリスク要因

	2023/3期		2024/3期		
	実績(百万円)	構成比(%)	予想(百万円)	構成比(%)	前年比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	12,500	43.1	+4.4
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	3,800	13.1	+2.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	12,000	41.4	△7.1
その他	659	2.3	700	2.4	+6.2
合計	29,265	100.0	29,000	100.0	△0.9

## (5) 中期経営計画の進捗





社是

心技一体

経営理念

経営の中心は人であり、  
健全なものづくりを通じて、  
豊かな社会の実現に貢献する。

## ビジョン2030

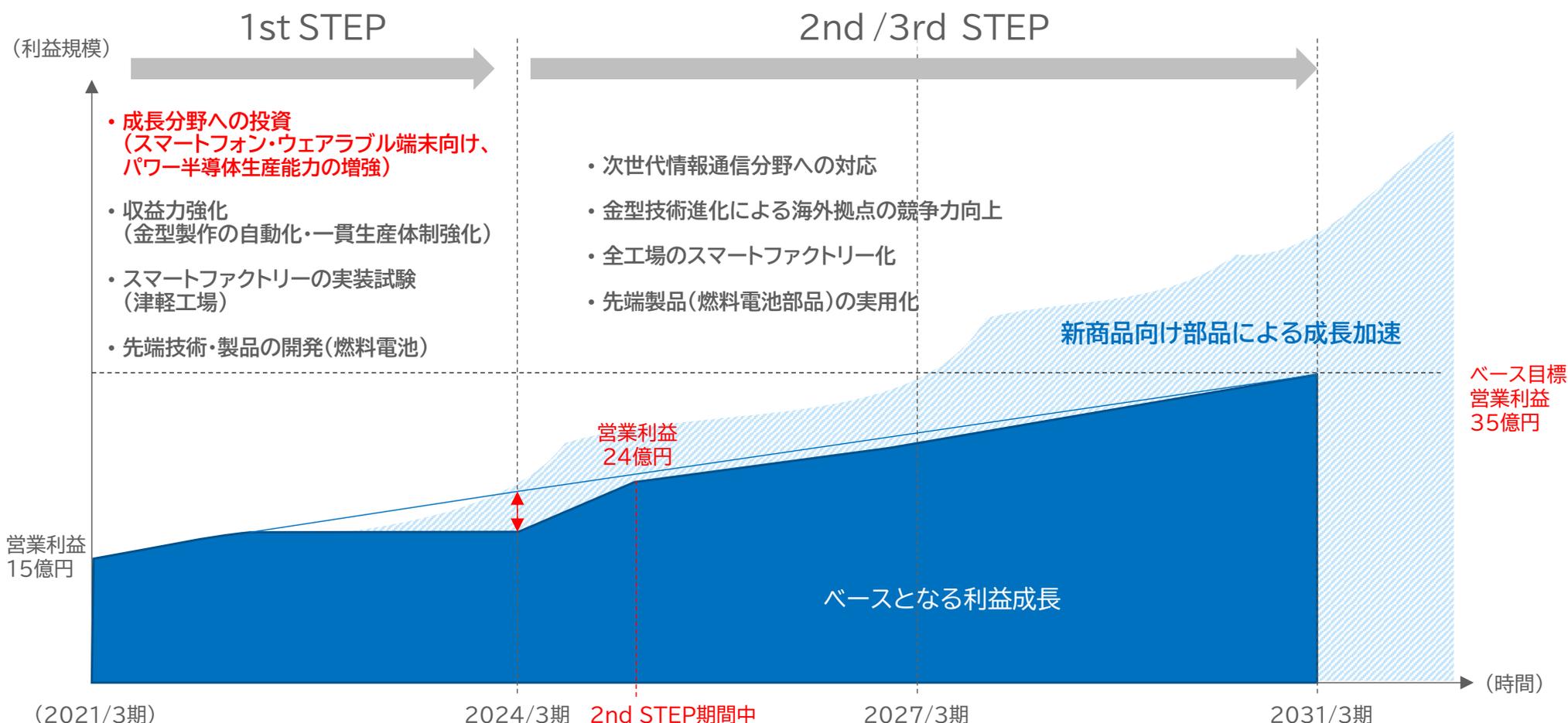
「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で  
暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

## ありたい姿

- 金型技術の進化で、最先端の市場に高品質な部品をスピーディに提供し続ける
- 失敗を恐れずチャレンジする職場環境づくりを通じてイノベーションを生み出す
- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する

- ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケットの成長を上回る利益成長を図る
- 2nd STEPで計画していたパワー半導体生産能力の増強を**1st STEPに前倒して実施**
- 津軽工場と中国新工場でメッキ工程の内製化(一貫生産体制強化)を行い付加価値を取込み **23年1-3月から稼働開始**



- 一貫生産体制強化のため、メッキ加工の内製化を進め、コネクタやリードフレームで付加価値向上を図る

津軽工場の新ライン



## 当社製品の主な製造工程



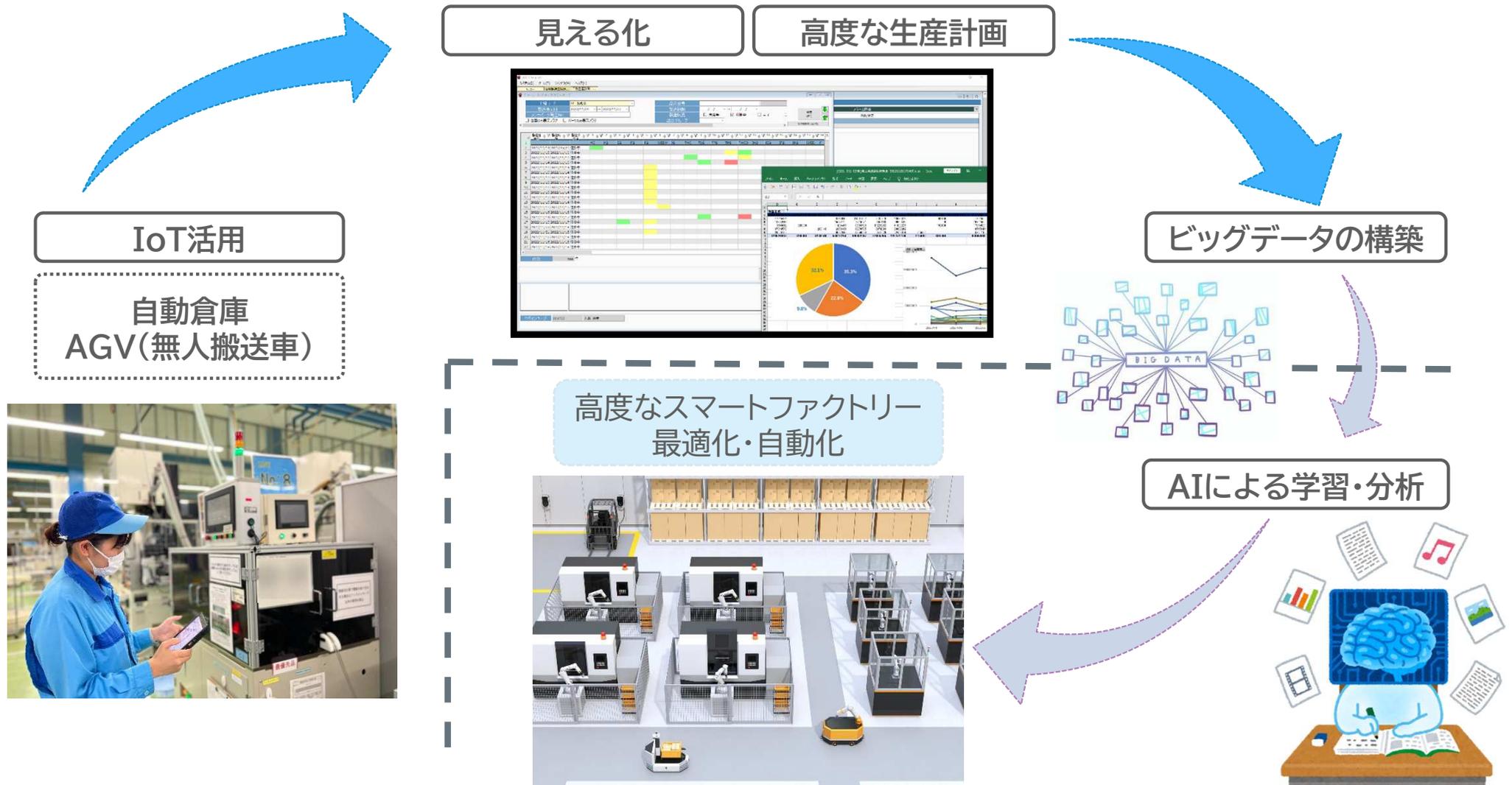
メッキの内製化でリードフレームとコネクタ製造の  
全工程をほぼ内製化  
さらなる付加価値の強化を目指す

- 津軽工場で1ライン、中国新工場で4ラインのメッキラインを新設。2023年1-3月期から稼働、量産に向け認定待ち
- 表面処理プロジェクト室を新設し、メッキ組織を強化

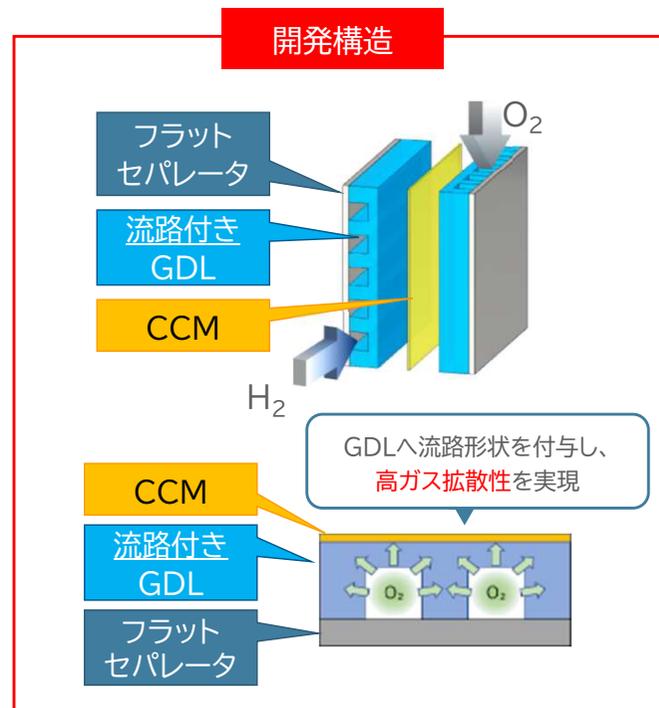
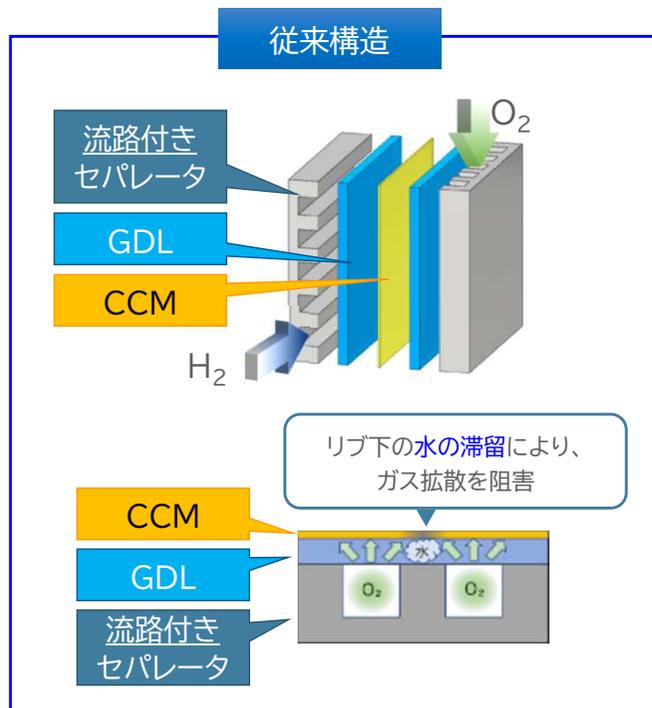
中国新工場



- ・ スマートファクトリー実現に向けて、2022年4月に新ERPシステムへの切り替えを実施
- ・ ビッグデータを構築し、AI活用した生産効率の向上や経営判断の迅速化につなげる



- 固体高分子形燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- 新開発の流路付きGDL(GDLFC<sup>+</sup>)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術により汎用樹脂にガス流路を成形
- 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスケットと一体化し、コストを削減
- 2025年に燃料電池車向けのテスト開始、将来はFCV、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



## 2021年5月

日本で初めて制作された国産の燃料電池を電源とする電動アシスト自転車に当社製「ガス拡散層一体型セパレータ」が搭載

## 2021年7月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)共通課題解決型産学官連携研究開発事業に採択

→採択期間は2025年3月まで更新

## 2022年3月

山梨大学及び大強度陽子加速器施設・J-PARCと連名で寄稿した論文が『Journal of Power Sources』(Elsevier社)にオープンアクセス版として掲載

## 2022年11月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文\*がアメリカ電気化学会(ECS)にオープンアクセス版として掲載

\* 「Improvement of PEFC Performance Stability under High and Low Humidification Conditions by Use of a Gas Diffusion Layer with Interdigitated Gas Flow Channels (対向櫛歯型流路が形成されたガス拡散層が固体高分子型燃料電池セルの高加湿および低加湿条件下における出力安定性の向上に及ぼす影響)」  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac9edf>

- ・メインターゲットはFCV－2030年FCV市場規模3兆9,011億円
- ・2023年3月時点において特許6件(国際:4件、国内:2件)出願中
- ・量産に向け2015年比約1/10コストへの削減を目指す

1st STEP(2021~2023)

2nd STEP(2024~2026)

3rd STEP(2027~2030)

FCV向け  
現行モデル

- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ラインの稼働実験
- ・顧客開拓

- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ライン準備
- ・顧客開拓

- ・量産開始
- ・2030年実用化へ

エネルギー  
その他

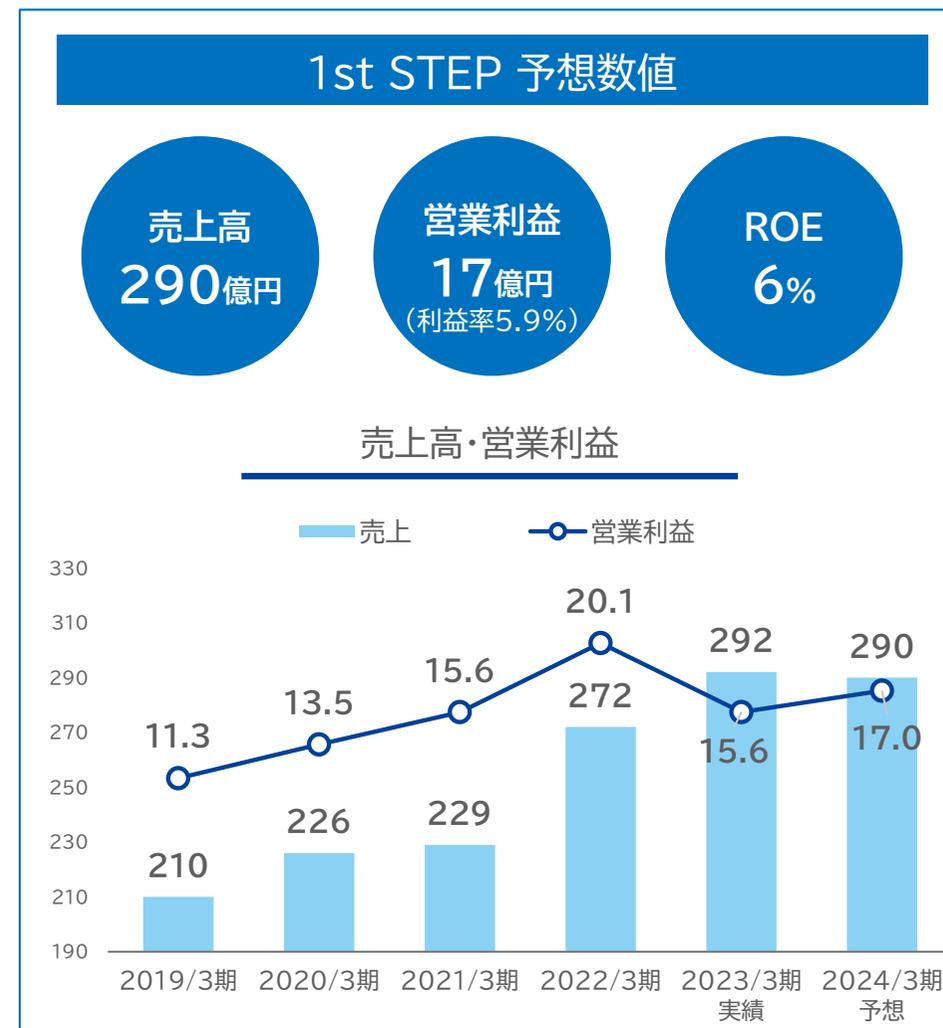
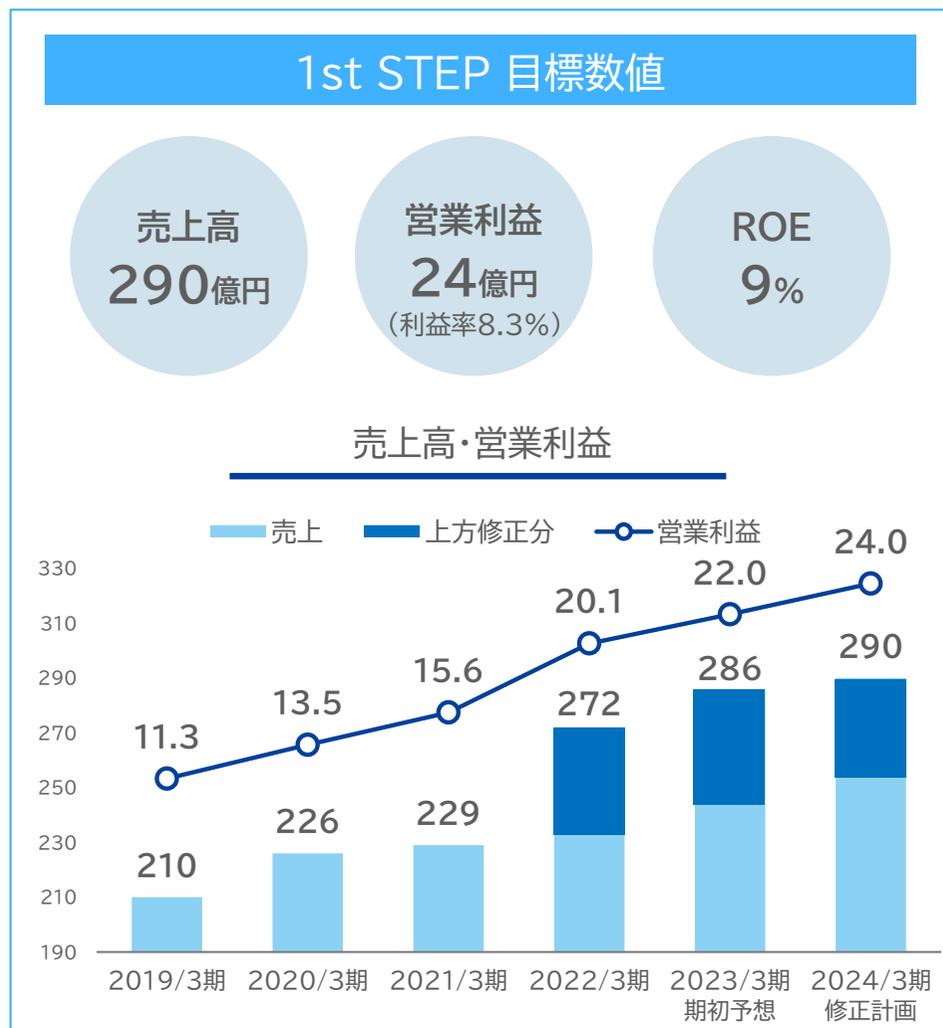
- ・顧客開拓
- ・顧客仕様、条件への適用開発
- ・量産ライン稼働→実用化へ

- ・FCV、ドローン、  
緊急電源、エネファーム等での実用化を図る

- ・改良型燃料電池の製造・研究開発・実用化による、水素社会の普及に貢献
- ・山梨県、山梨大学等と共に、産官学連携による燃料電池の研究開発の推進
- ・政府も本燃料電池の研究開発を支援、文科省に引き続きNEDOの研究開発事業に採択

(\*1)FCV市場規模 出所:富士経済・2021年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望

- 2022年3月期の営業利益は20億円となり中期経営計画の数値目標を達成し、24億円に修正  
しかし、スマートフォン向けの生産調整の他、エネルギーコスト等の費用増により2023年3月期は営業減益
- 中期経営計画1st STEPの数値目標は次期中期経営計画期間中での達成を目指す



- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け  
次期中期経営計画「2nd STEP」での「1st STEP」数値目標達成を目指す
- 先行指標の金型受注は前年同期比約2倍と急増しており、足下の生産調整後の需要回復に大きな期待

<p>パワー半導体用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディング式リードフレームを拡販 ⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化</li> </ul>
<p>オプト用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 車載/民生向け部品のLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立</li> </ul>
<p>コネクタ用部品</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ</li> <li>• 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販</li> </ul>
<p>メッキライン(内製化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上</li> </ul>

## 配当方針の変更

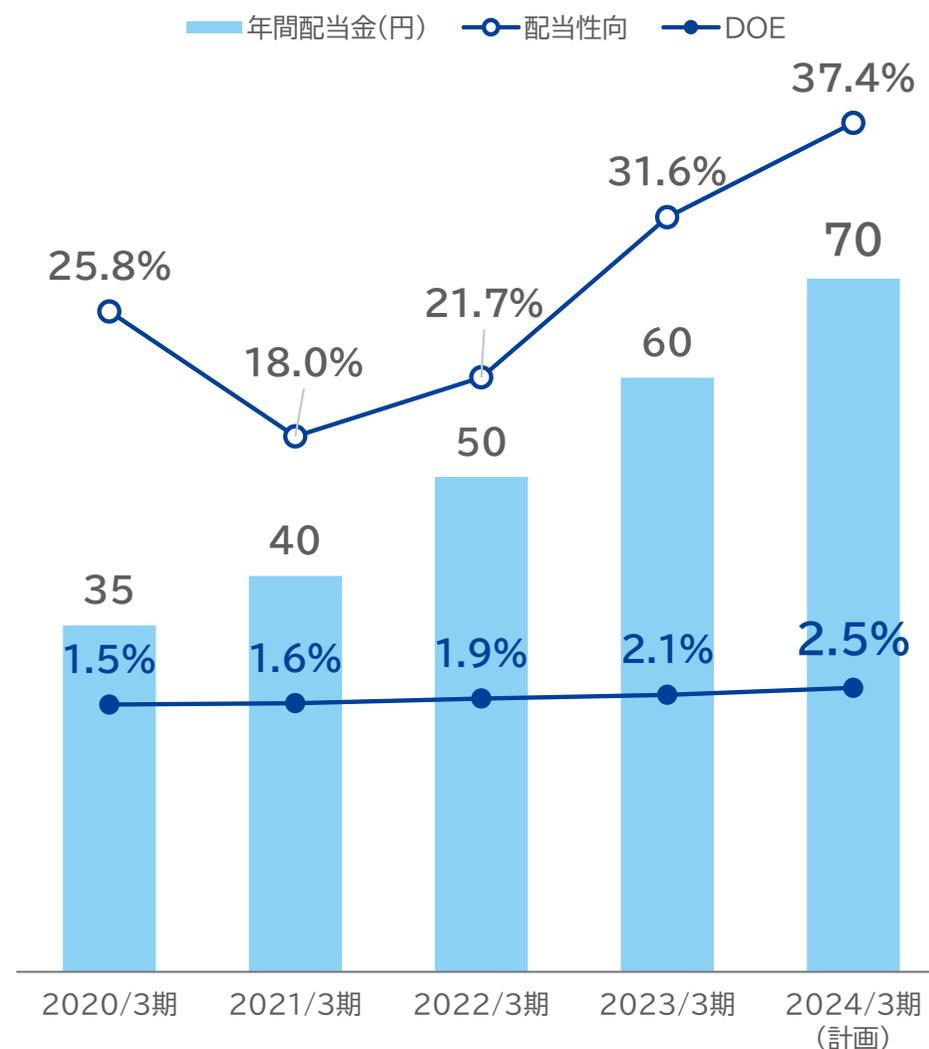
### 2024年3月期以降の配当方針

- DOE\*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は70円配当を予想 (DOE2.5%)

### 従来の配当方針

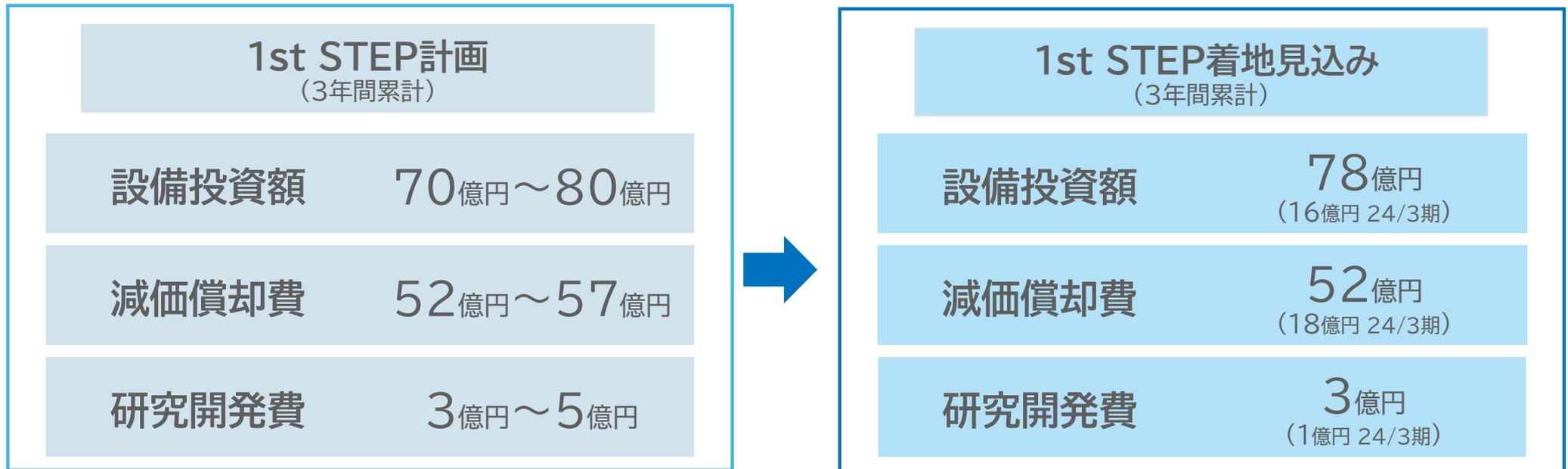
- 配当性向25%以上を目安に安定配当を継続

配当金・配当性向の推移



\* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

- ・ 津軽工場増設に加えて、リードフレームの増産等により、中計見直し後の設備投資計画70億円～80億円に対し78億円を実施予定、3年間の減価償却費も当初の52～57億円に対し、52億円となる見込み
- ・ 研究開発は計画通り進捗、3年間累計で3億円を計画



## 主要設備投資

- ・ メッキ工程内製化投資 9～10億円
- ・ 津軽工場増築 31億円 (スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタの増産)
- ・ パワー半導体用リードフレームの増産 10億円
- ・ スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- ・ 再エネ・省エネ投資 9億円

## (6) 中期環境計画の進捗(SDGsへの取組み)



2030年度 目標

**GHG排出総量** 5,541 t-CO<sub>2</sub>

**GHG排出削減量** 2,770 t-CO<sub>2</sub> (2012年度比)  
再エネ活用 1,400 t-CO<sub>2</sub>  
省エネ対策 1,370 t-CO<sub>2</sub>

## アクションプラン

1

### 再エネ活用

- 津軽工場への太陽光発電設備の設置 (2023年1月完成予定) など
- カーボンフリー電力の購入

GHG排出削減量 **1,400 t-CO<sub>2</sub>**  
2012年度比 **16.85% 削減**

化石燃料による  
電力購入削減量 **約3,400,000 kwh**

2

### 省エネ対策

コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

GHG排出削減量 **1,370 t-CO<sub>2</sub>**  
2012年度比 **16.48% 削減**

電力使用削減量 **3,161,713 kwh**

	中期環境計画 (2030年目標)	2023年3月期 実績	主な取り組み
GHG排出量	2,770 t-CO <sub>2</sub> 削減 (2012年度比33.33%減)	983.98 t-CO <sub>2</sub> 削減 (2012年度比 11.8%削減)	
・再生エネルギー活用	1,400t 削減 (2012年度比16.85%減)	-	・津軽工場への太陽光導入 2023年4月より稼働開始 年間発電量 約200万kWh
・省エネ対策	1,370t 削減 (2012年度比16.48%減)	983.98 t-CO <sub>2</sub> 削減 (2012年度比 11.8%削減)	・コンプレッサーの更新 ・空調設備の更新 ・生産設備の見直し、待機電力の削減

### 太陽光発電設備の設置

#### 2023年度完成予定

##### ◆本社(塩山)技術棟



発電容量:約634kW  
年間発電量:約770千kWh

##### ◆中山益能達精密電子有限公司



発電容量:約688kW  
年間発電量:約688千kWh

<効果>

**GHG排出削減量**

**約735t-CO<sub>2</sub>**

#### 参考情報

本社(塩山)



本社(上野原)



本社(塩山屋根)



津軽



2023年4月  
稼働開始

フィリピン



中国



既存の発電容量:国内海外合わせて約3.3MW  
左記完成後の発電容量:約4.6MW

- 単体での中期環境計画に加えて、2023年4月にはグループベースでの中期環境計画を作成

当社グループ全体

2030年度 目標

**GHG排出総量** 11,080 t-CO<sub>2</sub>

**GHG排出削減量** 6,732 t-CO<sub>2</sub> (2021年度比)   
 { 再エネ活用 4,488 t-CO<sub>2</sub>   
 省エネ対策 2,244 t-CO<sub>2</sub>

## アクションプラン

1

### 再エネ活用

- 太陽光発電設備の設置
- カーボンフリー電力の購入
- EV車両の導入

**GHG排出削減量** 4,488 t-CO<sub>2</sub>   
 2021年度比 **25% 削減**

化石燃料による **約8,160,000 kwh**   
 電力購入削減量

2

### 省エネ対策

コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

**GHG排出削減量** 2,244 t-CO<sub>2</sub>   
 2021年度比 **13% 削減**

**電力使用削減量** 約4,080,000 kwh

ご清聴ありがとうございました

# (7) Appendix



- 下期増収による売上債権の増加や、津軽工場の増設などコネクタ用部品等の増産投資により有形固定資産が増加

単位:百万円	2022/3期末	2023/3期末	前期末比増減
流動資産	17,006	19,051	+2,045
（内、現預金）	4,365	4,041	△324
（内、受取手形及び 売掛金及び契約資産）	7,790	8,617	+827
固定資産	13,167	14,988	+1,820
（内、有形固定資産）	11,861	13,501	+1,640
総資産	30,174	34,039	+3,865
負債	11,545	13,444	+1,899
（内、有利子負債）	2,150	3,132	+982
純資産	18,628	20,594	+1,966
負債純資産	30,174	34,039	+3,865

- ・ 営業キャッシュフローは減益と円安に伴う外貨換算額の増加による棚卸資産の増加等で減少
- ・ 津軽工場の増築に伴う投資等により、フリーキャッシュフローは約12億円のマイナス

単位:百万円	2022/3期	2023/3期	前期比増減
営業活動によるキャッシュフロー	3,331	1,810	△1,521
税金等調整前当期純利益	2,083	1,664	△418
減価償却費	1,664	1,717	+53
棚卸資産の増加	△859	△1,057	△197
投資活動によるキャッシュフロー	△2,965	△2,998	△33
有形固定資産の取得による支出	△2,840	△2,808	+32
財務活動によるキャッシュフロー	386	535	+149
長期借入れによる収入	1,000	900	△100
長期借入金の返済による支出	△99	△267	△168
配当金の支払い額	△408	△408	0
現金及び現金同等物の期末残高	4,365	4,041	△324
フリーキャッシュフロー	366	△1,188	△1,554

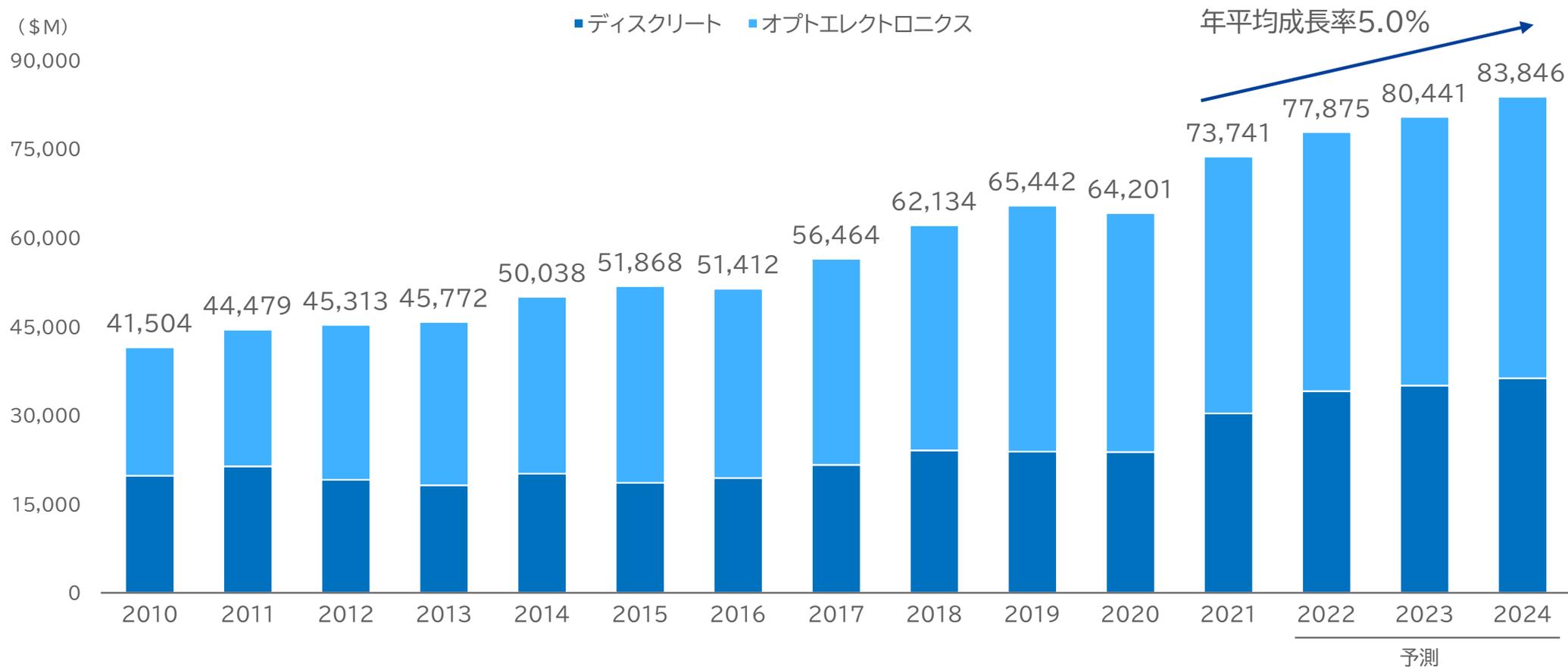
- 2023年3月期はコネクタ用部品で津軽工場でのメッキ工程の生産設備を導入、パワー半導体用リードフレームは2nd STEPで計画していた中国工場などへの増産投資を前倒しで実施
- その他は、太陽光発電設備等のGX関連投資
- 2024年3月期は維持・更新投資を中心に16.8億円の設備投資を計画

単位:百万円	2022/3期	2023/3期	2024/3期予想	前期比増減
設備投資	3,127	2,979	1,681	△1,297
パワー半導体用 リードフレーム	330	897	402	△494
オプト用 リードフレーム	111	307	83	△223
コネクタ用部品	2,384	1,136	872	△264
その他	301	637	322	△315
減価償却費	1,664	1,717	1,826	+108

# リードフレーム市場における ディスクリートとオプトエレクトロニクスの動向

- ・ ディスクリート市場は、パワー半導体等が車載やデータセンター、5G基地局向けなどにより中期的にも大きく成長
- ・ オプトエレクトロニクス市場は、車載向けの搭載率上昇や、デジタルサイネージ・大型ディスプレイの需要回復などの要因から成長が続く

世界のディスクリート半導体とオプトエレクトロニクス市場予測

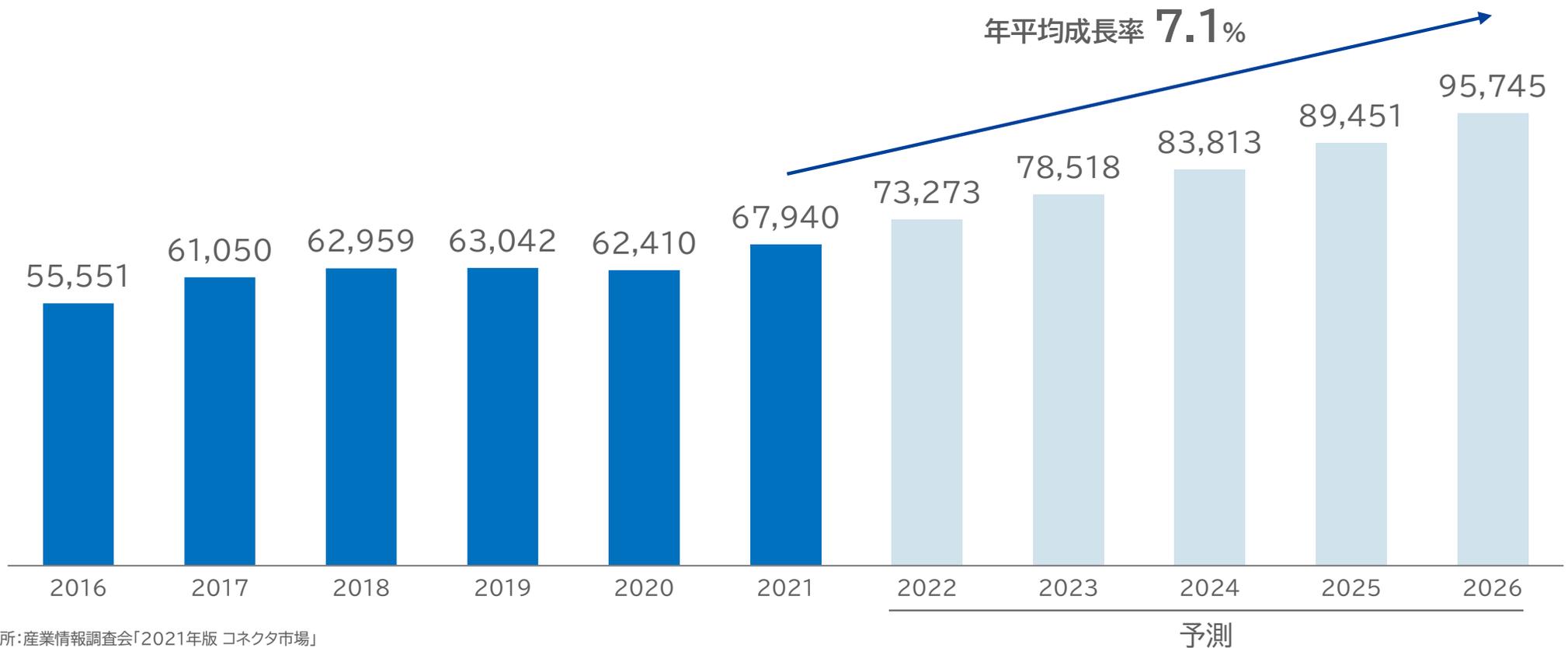


出所:WSTS「世界半導体市場統計」とOmdiaのデータをもとに当社作成

- コネクタ市場も年平均7.1%の成長が続くと予想
- 2020年以降は車載向け部品の搭載率上昇、スマートフォンの高機能化やウェアラブル端末などのワイヤレス化が市場を牽引

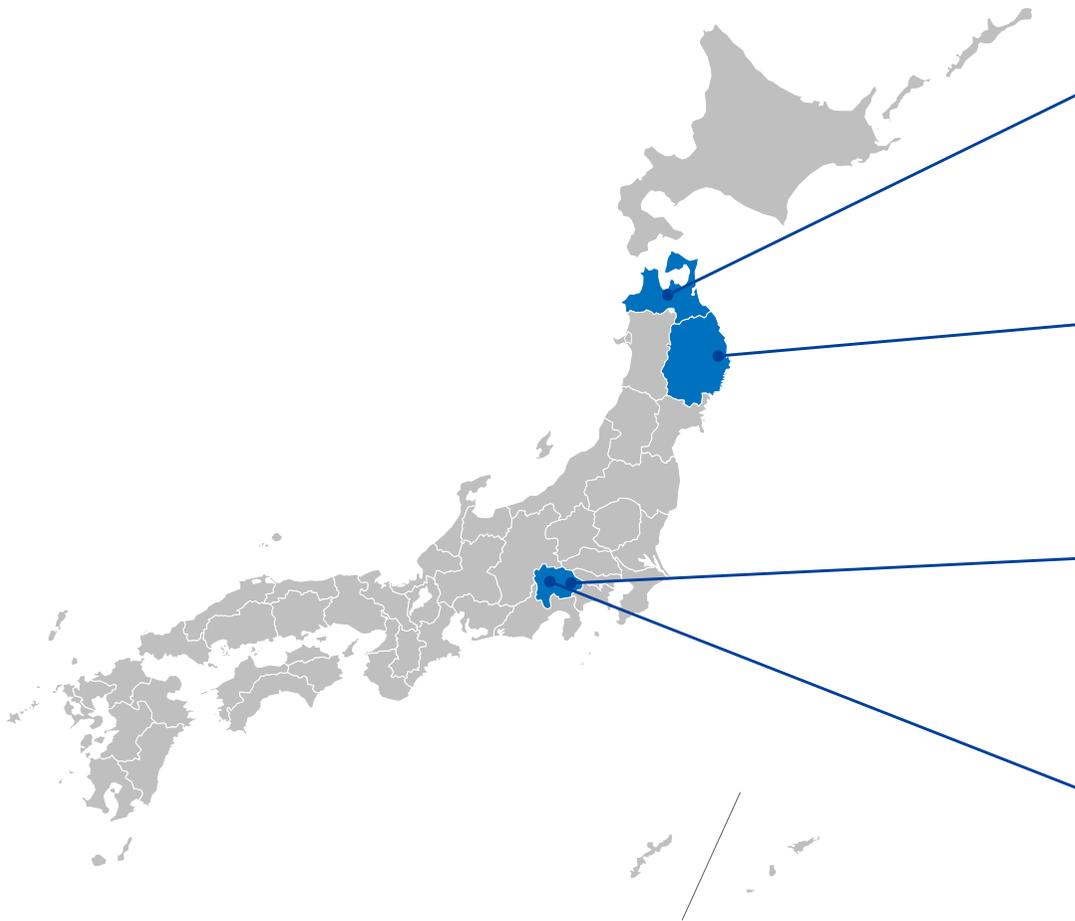
コネクタ世界市場規模の推移と需要予測

単位:億円



出所:産業情報調査会「2021年版 コネクタ市場」

- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、マイクロコネクタの生産能力を増強、5年間の投資額は31億円を計画
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・高電流対応品の生産体制を強化



## 津軽工場

主要生産品目

スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



## 岩手工場

主要生産品目

車載向け受動部品

スマートフォン向けコネクタ



## 本社工場(上野原)

主要生産品目

オプト用リードフレーム

リレー部品



## 本社工場(塩山)

主要生産品目

IC・トランジスタ向けリードフレーム

オプト用リードフレーム

- 中山工場(中国)では、リードフレームやコネクタ用部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- フィリピン工場では、車載向けのコネクタ用部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

## 中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**  
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**  
主要生産品目 IC・トランジスタ用リードフレーム  
スマートフォン向けコネクタ用部品

## フィリピン

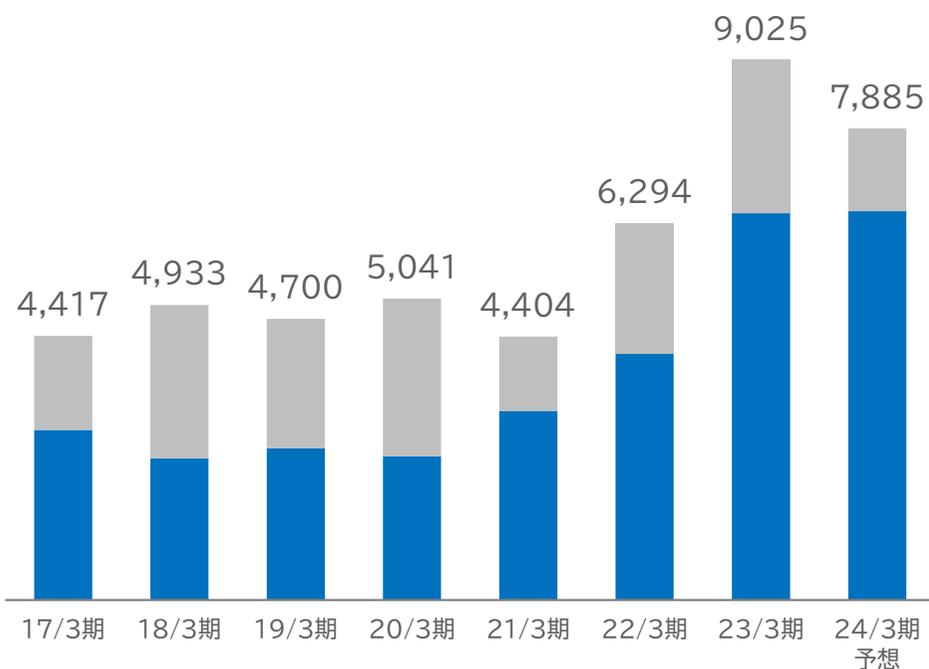


生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**  
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ用部品  
車載向けスイッチ部品  
IC・トランジスタ用リードフレーム

- 日系機器メーカーの工場移転や海外企業の台頭に対応し、中国・フィリピンでも金型から一貫生産
- 中国工場ではクリップボンディングリードフレームを国内メーカーに先駆けて大量生産、日本企業と同タイプ製品への本格参入にあたり、当社グループは量産実績を背景に受注で優位に
- フィリピン工場では車載向け部品が成長

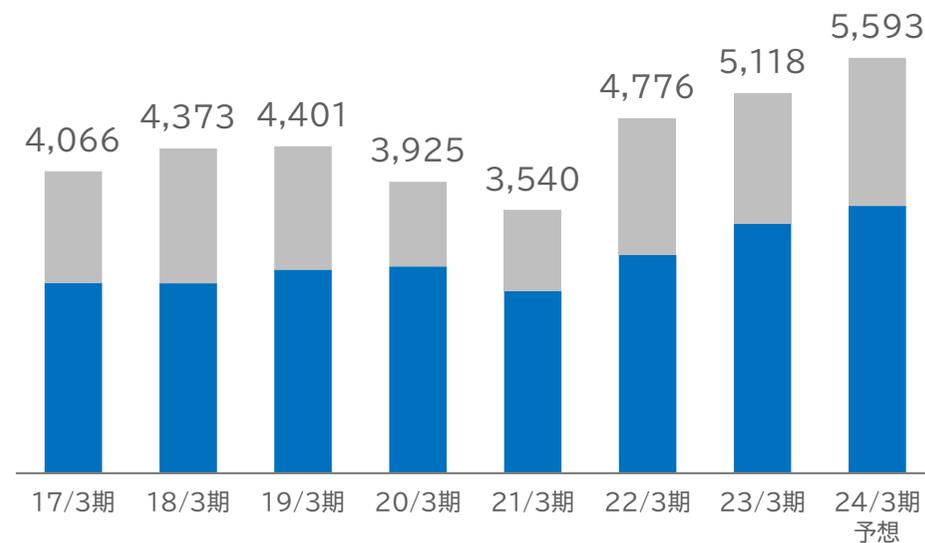
### 中国子会社の売上高推移

■内、パワー半導体用リードフレーム(百万円)

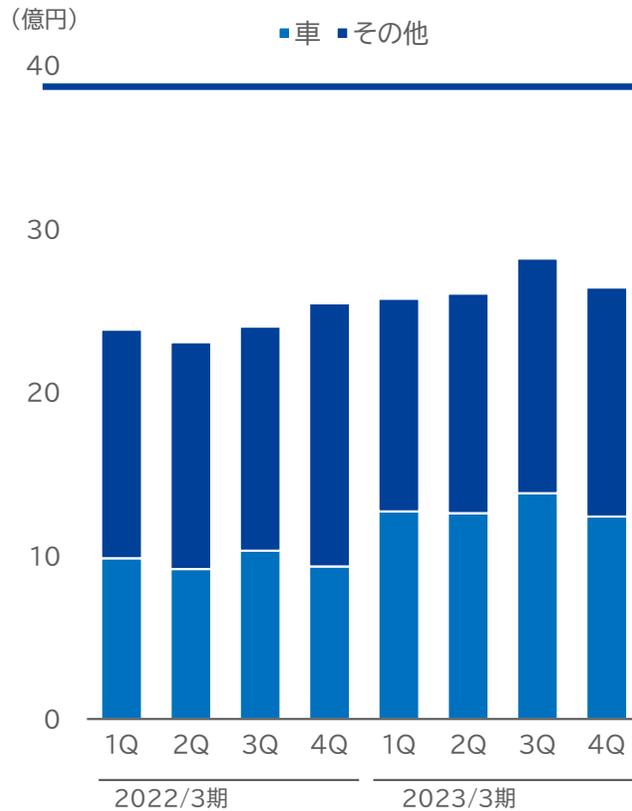


### フィリピン子会社の売上高推移

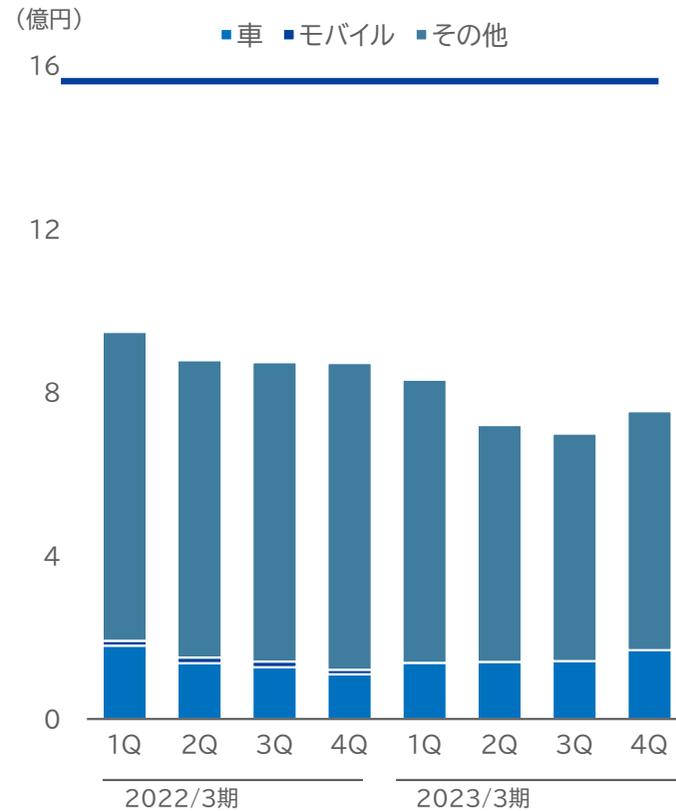
■内、車載向け部品(百万円)



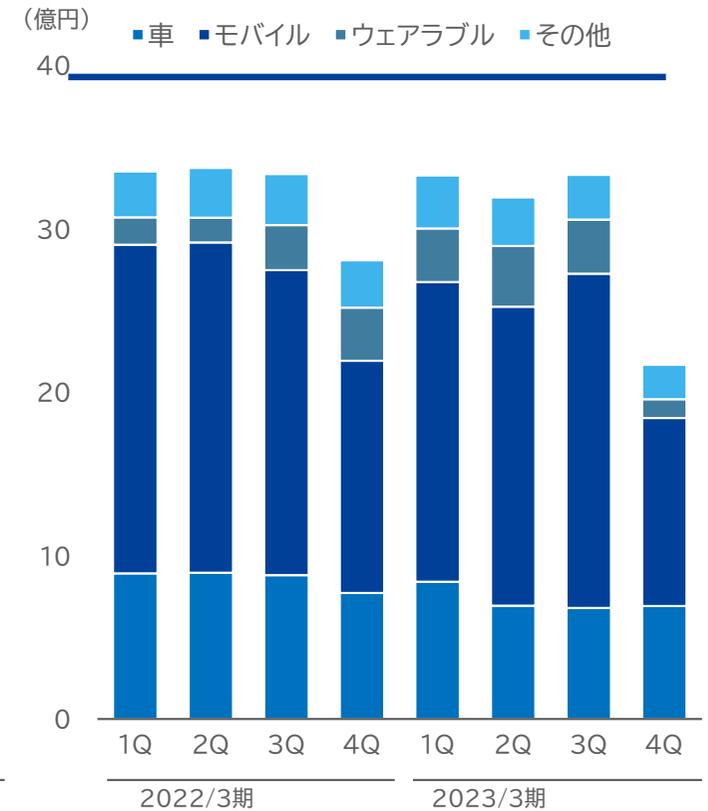
## パワー半導体用リードフレーム



## オプト用リードフレーム

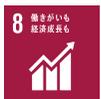


## コネクタ用部品



注:用途別量産品売上高は為替レートを固定した売上高で算出しており、製品群別売上高の数値とは一致しない

- SDGsへの取り組みとして以下を策定し、順調に進捗
- 2022年5月には中期環境計画を定め、2030年のGHG排出削減量を定めて、取り組みを強化
- 2023年5月には海外工場等も含む連結での中期環境計画を策定

重点分野	関連するSDGs	現在の取り組み	1st STEPでの対応策
脱炭素社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 産官学連携による燃料電池部品開発</li> <li>• 太陽光パネルの設置</li> <li>• 照明の完全LED化推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 燃料電池部品の量産ライン稼働実験</li> <li>• 太陽光パネルの増設(津軽工場に設置)</li> <li>• 二酸化炭素排出量の測定と開示法の策定</li> </ul>
誰もが活躍できる社会の実現	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 子育てのしやすい環境の整備(プラチナくるみん*)</li> <li>• 在宅勤務制度の実施</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度活用促進によるプラチナくるみんの継続</li> <li>• 多様性を重視した管理職育成</li> <li>• 障がい者・外国籍雇用体制の更なる拡充</li> <li>• 健康優良企業「銀の認定」更新</li> </ul>
みんなが幸せになれる社会の実現	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• フードバンク活動</li> <li>• 学習支援活動への協賛</li> <li>• 地域活動、スポーツ団体への協賛</li> <li>• ボランティア休暇制度実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 採用活動や経済活動を通じた地域との共生</li> <li>• リサイクル活動強化</li> </ul>

\*プラチナくるみん：次世代育成支援対策促進法に基づき、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる企業を認定

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。